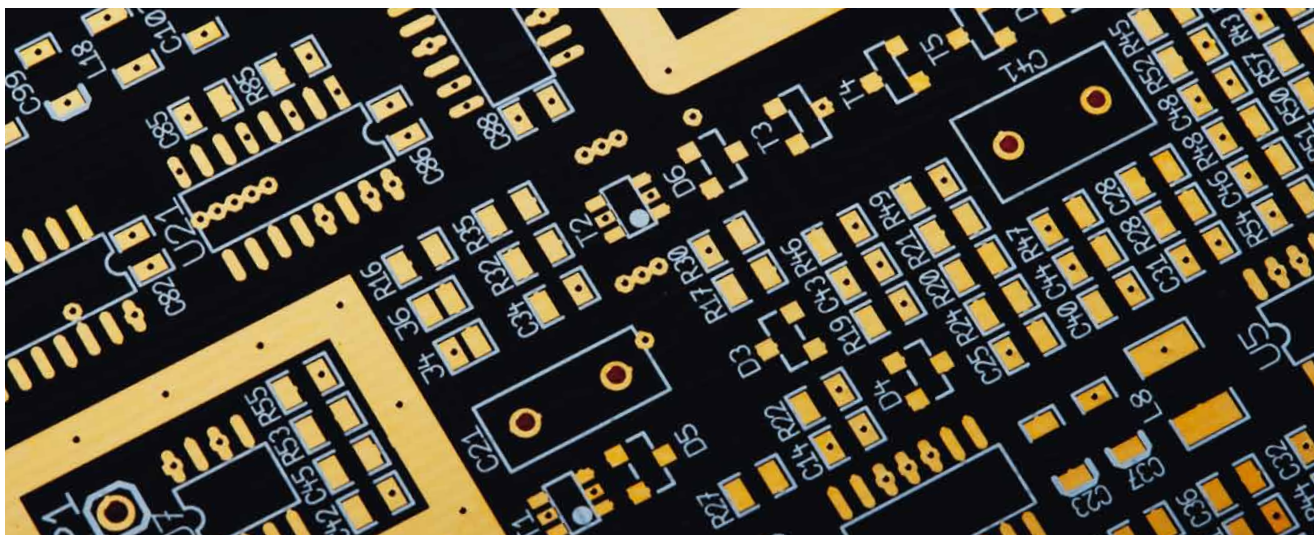


Die Herstellung von Standardleiterplatten zählt zum Kerngeschäft unseres Unternehmens. Gleichermaßen präzise arbeiten wir an der Entwicklung maßgeschneiderter, innovativer Lösungen – wie z. B. AML®, AlepTwin® oder IFP – mit denen wir den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden können.

## LEITERPLATTEN

INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN,  
INNOVATIVE TECHNIK



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser Kerngeschäft ist die Entwicklung und Fertigung von Leiterplatten in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen. Durch einen hohen Grad an Spezialisierung, verbunden mit jahrzehntelang aufgebautem fachlichen Know-how und einem mit modernster Technik ausgestatteten Maschinenpark, sind wir in der Lage, Leiterplatten mit einer Vielzahl von Eigenschaften und Anpassungen auszustatten und damit für eine nahezu unbeschränkte Anzahl von Anwendungen und spezifischen Umgebungen verfügbar zu machen.

Ob ein- oder zweiseitige Ausführungen, ob die Fertigung von Multilayern mit bis zu acht Lagen oder die Verwendung innovativer Techniken bei der Herstellung von Aktiven Multi Layern (AML) oder Frontplatten mit integrierten Bauteilen: Unsere Leiterplatten lassen maximalen Raum für Kundenanforderungen und genügen in jeder Phase ihrer Entwicklung und Fertigung höchsten Qualitätsansprüchen. Dies gilt auch für die Nutzung unterschiedlicher Materialien und Oberflächen sowie die Einbindung von Sondertechniken, Lacken und Drucken.

### SPEZIFIKATIONEN

#### Ausführungen

- einseitig oder zweiseitig DK (durchkontaktiert)
- Multilayer von bis zu 8 Lagen
- Hybrid-Multilayer (u. a. Rogers / FR4)
- ein- oder zweilagige Flexschaltungen

#### Sondertechniken

- Blind Vias
- Burried Vias
- AML® Aktiver Multi Layer (Embedded Components)
- Frontplatten mit integrierten Bauteilen (IFP)

#### Lacke & Drucke

- Lötstopplack in verschiedenen Farben (grün, weiß, schwarz, rot, blau)
- Positionsdruck im Fotodruck (weiß, schwarz)
- abziehbarer Lötstopplack (Lötabdecklack)

## TECHNISCHE DATEN ZUR LEITERPLATTE

### Leiterplattenausführungen

Wir verwenden nur hochwertige Ausgangsmaterialien, z. B. Basismaterial von ISOLA, Rogers, Arlon, Panasonic, DuPont oder auf Wunsch von anderen Herstellern.

Um eine optimale Umsetzung Ihrer Produktanforderungen zu gewährleisten, nutzen wir die Möglichkeiten neuer, innovativer Technologien. Das gilt sowohl für die Produkte selbst als auch für die Entwicklung neuer Fertigungstechniken.

#### Abmessungen

- max. Leiterplattengröße 590 x 490 mm
- min. Leiterplattengröße ohne Beschränkungen
- Leiterplattenstärke min. 0,1 mm / max. 6,0 mm

#### Leiterbahnbreiten / -abstände

- Standard (35 µm Cu-Auflage) > 125 µm
- Sonderausführung 90-125 µm

#### Kupferauflagen

- Standard (Endstärke) 35 µm
- Sondertypen 70 / 105 / 130 / 200 / 400 µm
- Kupferauflage in der Hülse >= 25 µm

#### Bohr- / Fräsdurchmesser

- min. Bohrdurchmesser >= 150 µm
- Microvias (gebohrt) >= 150 µm (Aspect Ratio max. 1:1)
- Standard-Fräsdurchmesser 2,0 mm
- min. Fräsdurchmesser 0,6 mm

#### Heatsink

- Aluminium oder Kupfer gefräst Dicke: 0,5-10,0 mm

#### Datenformate

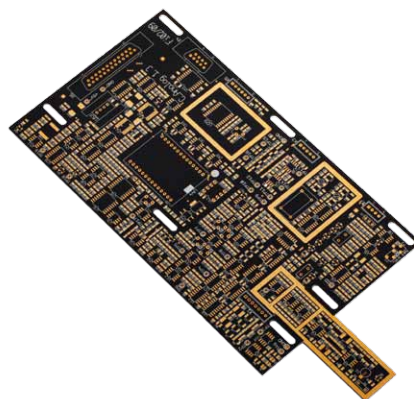
- Gerberdaten
- Bohrdaten (Sieb & Meyer, Excellon)
- DXF-Daten
- HPGL-Daten
- CAD-Daten (Target, Eagle)

#### Zulassung

- UL-Zulassung

#### Testmöglichkeiten

- **Elektrischer Test der Leiterplatten nach Gerberdaten**  
Standard bei Multilayern und sonstigen Leiterplatten mit Strukturen < 125 µm optional bei doppelseitigen Leiterplatten mit Strukturen > 125 µm
- **Optionaler Hochspannungstest**  
bis 2 kV bei MCPCB-Schaltungen (z. B. aus AlepTwin® oder Thermal Clad)
- **AOI (Automatische Optische Inspektion) bei Multilayer Standard**



### SERVICE & LIEFERZEITEN

Als Spezialist für Leiterplatten sind wir in der Lage, auch höchst komplexe und ungewöhnliche Anforderungen bei der Fertigung von Platinen und ihrer Komponenten zu erfüllen. Ob Kleinserien oder Sonderanfertigung, Prototypen oder Muster: Stets verbinden wir qualitativ hochwertige Arbeit mit kompetenter Beratung bei der Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen und Ideen.

#### Lieferzeiten Standard

- 7 Arbeitstage für einseitige Leiterplatten
- 10 Arbeitstage für doppelseitige Leiterplatten und Multilayer

#### Lieferzeiten Eilservice

- 24 Stunden für einseitige Leiterplatten (Auftragseingang am Morgen, Versand am selben Abend)
- 2 Arbeitstage für doppelseitige Leiterplatten und Multilayer



Hofmann Leiterplatten GmbH  
Auerbacher Straße 4  
93057 Regensburg  
Deutschland

Tel. +49 (941) 604 90 - 0  
Fax +49 (941) 604 90 - 20

info@hofmannlp.de  
www.hofmannlp.de